

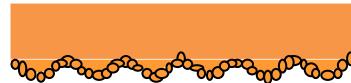
# MW-G

- MW-G銅箔は環境に配慮した銅箔で、特にHi-Tg材やハロゲンフリー材に適しております。  
MW-G copper foil comply with environment regulation is especially suitable for Hi-Tg and Halogen Free prepgs.
- 十分な接着強度/優れた耐熱性/良好なエッチング特性  
Good bonding strength./ Excellent heat resistance./ Good etchability.
- 最薄の9  $\mu$  mを安定して生産対応が可能でお客様のご要求を満足いたします。  
Our plant has stable capacity for 9  $\mu$  m thin foil to fulfill customer requirements.

## 用途/Application

- HDIマイクロビア配線板  
/High Density Interconnect(HDI)
- パッケージ配線板(薄箔)  
/Semiconductor Package(thin copper foil)

## 構成/Composition



## 生産拠点/Production Site

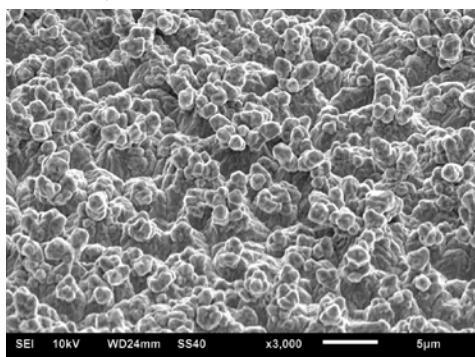
- 台湾 / Taiwan
- マレーシア / Malaysia

## 代表的特性値/Representative data

	$\mu$ m	R <sub>z</sub> ( $\mu$ m)	Tensile Strength (N/mm <sup>2</sup> )	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
MW-G	9	3.8	370	4	0.9
	12	4.2	370	6	1.2

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。  
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side

